

MSOP10/QFN12-0.5mm-DIP 轉接板 MSOP10/QFN12 轉 DIP

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品規格

板層：2層板（又稱雙面板或雙層板）正面：DFN/MSOP10 轉 DIP10 Pitch：0.5mm
DIP：7.62*2.54mm；反面：QFN12 轉 DIP Pitch：0.5mm，DIP：2.54mm

板材：FR4 板材（採用 KB 公司軍工級 A 級環保板材，軍工品質）該板材的絕緣性，板
材的均勻性，銅皮跟板材基材的可靠性並且銅皮不易縮水，板材的阻抗穩定性；板厚：
1.6mm 超厚不易變形

焊盤：採用化學沉金工藝（即焊盤表面鍍金）焊點更牢靠、防腐蝕、抗氧化、無鉛更環保

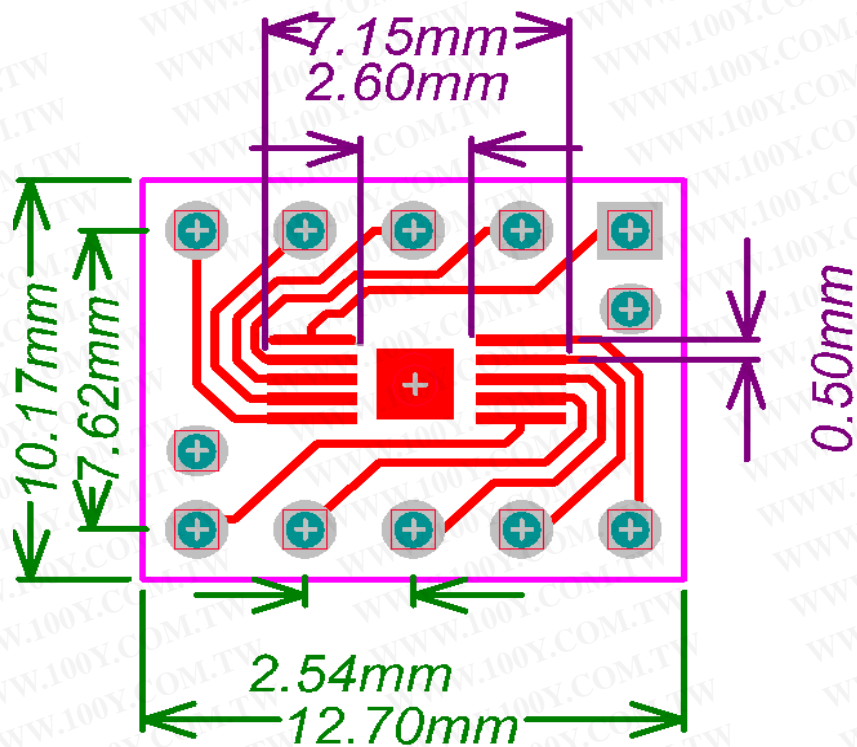
產品用途

本轉接板適用於以下“貼片芯片封裝”轉成插件：

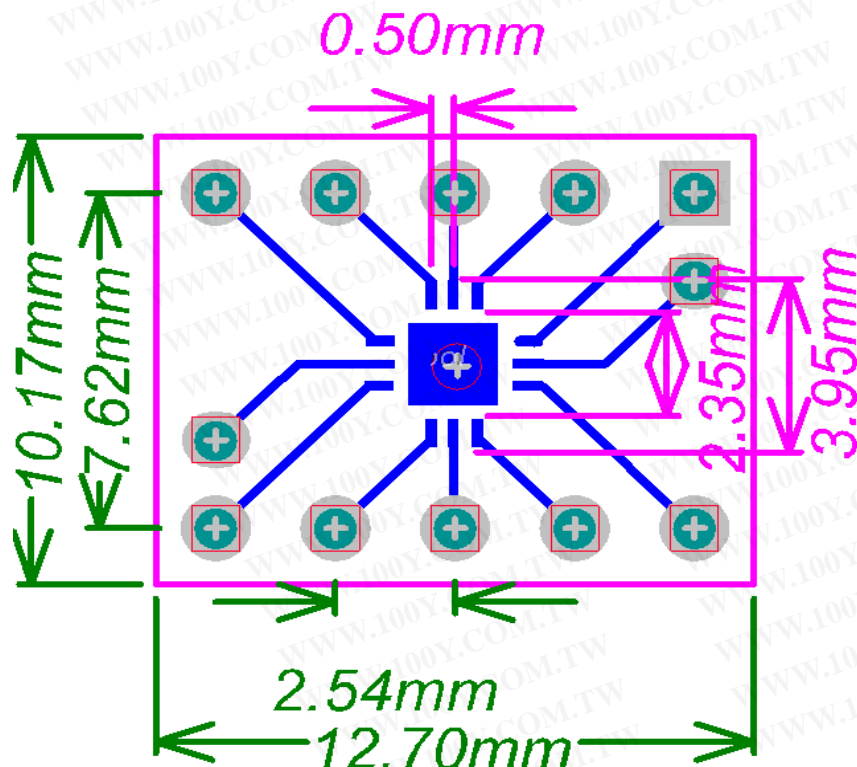
DFN10/MSOP10 轉 DIP10 Pitch：0.5mm 即：焊盤間距離（引腳間距）<焊接位置：轉接
板正面>

QFN12 轉 DIP Pitch：0.5mm 即：焊盤間距離（引腳間距）<焊接位置：轉接板背面>

<正面> : MSOP10 焊盤間距 Pitch : 0.5mm DIP : 2.54mm



<背面> : QFN12 焊盤間距 Pitch : 0.5mm DIP : 2.54mm



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)